

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2006年12月21日 (21.12.2006)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2006/134629 A1(51) 国際特許分類:  
H05K 9/00 (2006.01) H01L 25/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/010785

(22) 国際出願日: 2005年6月13日 (13.06.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5308323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡野 貴史 (OKANO, Takashi) [JP/JP]; 〒5918511 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業株式会社 堺製作所 金岡工場内 Osaka (JP). 西村 政弥 (NISHIMURA, Masaya) [JP/JP]; 〒5258526 滋賀県草津市岡本町字大谷1000番地の2 ダイキン工業株式会社 滋賀製作所内 Shiga (JP). 川村 周平 (KAWAMURA, Shuhei) [JP/JP]; 〒5258526 滋賀県草津市岡本町字大谷1000番地の2 ダイキン工業株式会社 滋賀製作所内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 吉田 茂明, 外(YOSHIDA, Shigeaki et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル10階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

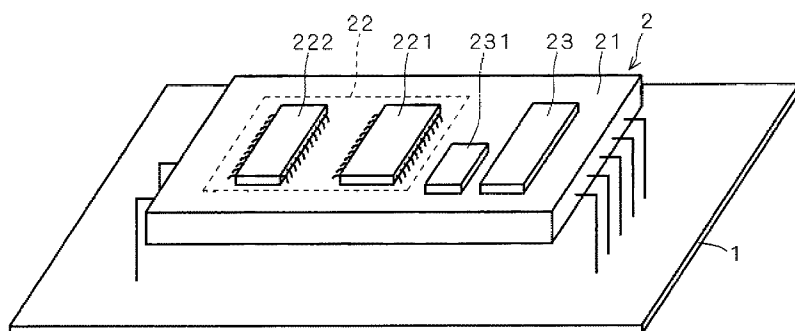
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTOR CIRCUIT BOARD AND SEMICONDUCTOR CIRCUIT

(54) 発明の名称: 半導体回路基板及び半導体回路



(57) Abstract: Noise countermeasures are efficiently taken for a semiconductor circuit board and a semiconductor circuit. The semiconductor circuit board is provided with a control board (1) and a semiconductor circuit (2) connected to the control board (1). The semiconductor circuit (2) is provided with a board (21), an integrated circuit group (22) and noise countermeasure means (23, 231), and is separated from the control board (1). The integrated circuit group (22) includes an

integrated circuit to be a noise generating source. The board (21) is a multilayer board and shifts the frequency of noise generated from the integrated circuit group (22) to high frequency. The noise countermeasure means (23) is a filter connected between the integrated circuit group (22) and the control board (1) and attenuates high frequency of noise.

[続葉有]



---

(57) 要約:

本発明は、半導体回路基板及び半導体回路に対してノイズ対策を効率良く行うことを目的とする。その構成は、制御基板（１）と制御基板（１）に接続される半導体回路（２）とを備え、半導体回路（２）は、基板（２１）、集積回路群（２２）及びノイズ対策手段（２３、２３１）を有し、制御基板（１）から分離されており、集積回路群（２２）は、ノイズ発生源となる集積回路を含み、基板（２１）は、多層積層基板であって、集積回路群（２２１）から発生するノイズの周波数を高周波側へとシフトさせ、ノイズ対策手段（２３）は、集積回路群（２２）と制御基板（１）との間に接続され、ノイズの高周波を減衰させるフィルタである。